

行业及产业
电子

华虹半导体筹划收购华力微控股股权
——电子行业周报（2025/8/18-8/22）

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业周报：Amazfit 产业链迎来业绩拐点》2025-08-20
- 《人工智能月度跟踪：WAIC 2025 聚焦多种大模型、AI 算力芯片和服务器》2025-08-18
- 《电子行业专题报告：全品类科技硬件产品的贸易风险分析》2025-08-15
- 《电子行业点评：AI 时代半导体的变与不变》2025-08-13
- 《电子行业周报：国产 GaN 芯片进入 NVIDIA 供应链》2025-08-11

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- **数字芯片设计大涨值得关注。**本周（2025/8/18-8/22）SW 电子行业指数(+8.95%)，涨跌幅排名 2/31 位，沪深 300 指数(+4.18%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信(+10.84%)，电子(+8.95%)，综合(+8.25%)，计算机(+7.93%)，美容护理(+5.35%)，涨跌幅后五分别为：房地产(+0.50%)，煤炭(+0.92%)，医药生物(+1.05%)，银行(+1.25%)，环保(+1.33%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：数字芯片设计(+16.36%)，半导体设备(+12.31%)，集成电路制造(+11.12%)；涨跌幅后三分别是：被动元件(+1.05%)，印制电路板(+1.84%)，品牌消费电子(+5.28%)。
- **华虹半导体筹划收购华力微控股股权。**2025 年 8 月 17 日，华虹半导体有限公司发布公告，为履行 IPO 时解决同业竞争的承诺，正筹划以发行股份及支付现金方式购买上海华力微电子有限公司（华力微）控股权，同时配套募集资金。本次收购标的为华力微运营的、与华虹半导体在 65/55nm 和 40nm 存在同业竞争的华虹五厂对应股权，目前该标的正处于分立阶段。
- **华虹集团实现工艺制程突破。**华力微 2010 年成立后逐步完成技术与管理体系搭建（2011 年 55nm 试流片、通过 ISO9001 认证）、工艺迭代与业务拓展（2013-2015 年 CIS 产品风险量产、40nm 量产及 28nm 芯片流片成功），并通过华虹六厂建设与汽车电子相关体系认证强化竞争力；2025 年 8 月华虹半导体拟收购其控股权，有望通过资源协同加速发展。华虹集团旗下二者分工明确：华虹半导体以成熟工艺为核心，运营上海、无锡 5 座产线（3 座 8 英寸、2 座 12 英寸），工艺覆盖 180nm-40nm，聚焦功率器件、传感器等特色代工领域；华力微则聚焦 12 英寸中，运营华虹五厂（65/55nm-40nm）并控股华虹六厂（28/22nm），集中布局上海产线，聚焦高端逻辑领域。
- **晶圆代工是集成电路产业链的核心枢纽。**上游依赖 EDA 工具、IP 授权、光刻设备及硅片提供技术与原料支撑，中游承接芯片设计方案，通过光刻、蚀刻等工艺将设计图案转移至硅片形成晶圆（工艺直接决定芯片性能与良品率），并对接下游终端应用实现价值落地，对产业链高效运转意义重大。从行业规模看，全球晶圆代工市场 2020-2024 年复合增速 15.4%，2023-2024 年市场规模分别为 1152.0 亿美元、1375.5 亿美元；中国大陆市场表现更优，2024 年规模 130.0 亿美元（占全球 9.4%），同期复合增速 18.8%，显著高于全球水平。从竞争格局看，2025Q1 全球市场高度集中，TrendForce 数据显示，TSMC 以 67.6%份额居首（凭借 3nm/2nm 先进制程、头部客户绑定及大产能优势），Samsung（8.1%）受良率、产能分配问题制约份额有限，SMIC（5.5%）依托政策、28nm 成本及本土需求立足；国产企业华虹集团亦占 2.7%全球份额，是国产晶圆代工的重要力量。
- **华虹半导体聚焦“8 英寸+12 英寸”差异化特色工艺开发与应用。**公司成立于 2025 年覆盖嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件等领域，核心提供晶圆制造服务，同时形成多元化产品与服务矩阵——除对应工艺的功率器件、模拟与电源管理芯片等外，还配套 IP 设计、测试及晶圆后道加工服务，全方位满足客户半导体制造需求。2024 年公司营业收入 20.04 亿美元，2019-2024 年复合增速约 16.5%，营收增长稳健。产销端，2020-2024 年晶圆产量、销量复合增速分别达 20.01%、18.32%，2023-2024 年产销率均超 100%（103.8%、100.7%）。
- **投资建议：**随着华虹收购华力微的推进，华虹半导体有望成功纳入 28nm 制程工艺产线。这一动作可补齐华虹半导体在汽车芯片制造领域的关键制程短板，增强其竞争能力，同时突破公司估值瓶颈。建议投资者重点关注华虹半导体的长期投资价值。
- **风险提示：**1) 国际贸易摩擦加剧 2) 下游需求不及预期 3) 技术升级进度滞后

目录

1. 华虹半导体筹划收购华力微控股权	4
1.1 华力微简介	5
1.2 全球晶圆代工市场格局	6
1.3 华虹半导体简介	8
2. 全球产业动态	10
2.1 小米发布 25Q2 财报	10
2.2 Deekseek 发布并开源 V3.1 模型	10
2.3 软银集团宣布 20 亿美元投资英特尔	11
2.4 高通发布新骁龙 W5	11
2.5 谷歌发布 Pixel 10 系列	12
3. 本周市场回顾	13
3.1 SW 一级行业涨跌幅一览	13
3.2 SW 电子三级行业市场表现	14
3.3 SW 电子行业个股情况	14
3.4 SW 科技行业其他市场表现	15
4. 风险提示	16

图表目录

图表 1：华力微发展史梳理	5
图表 2：华虹集团晶圆代工产线情况	6
图表 3：晶圆代工是集成电路产业链中重要环节	7
图表 4：全球、中国大陆晶圆代工市场规模及同比	7
图表 5：2025Q1 全球晶圆代工厂市场份额	8
图表 6：华虹半导体营收及同比	9
图表 7：2024 年华虹半导体营收（按地区分类）	9
图表 8：华虹半导体晶圆销量、产量及产销率	9
图表 9：本周 SW 一级行业涨跌幅一览	13
图表 10：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览	14
图表 11：SW 电子个股本周涨跌幅前十	15
图表 12：SW 电子个股本周涨跌幅后十	15
图表 13：本周费城半导体指数	15
图表 14：本周恒生科技指数	15
图表 15：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览	16

1. 华虹半导体筹划收购华力微控股权

2025 年 8 月 17 日，华虹半导体有限公司发布公告，为履行 IPO 时解决同业竞争的承诺，正筹划以发行股份及支付现金方式购买上海华力微电子有限公司（华力微）控股权，同时配套募集资金。本次收购标的为华力微运营的、与华虹半导体在 65/55nm 和 40nm 存在同业竞争的华虹五厂对应股权，目前该标的正处于分立阶段。华虹半导体从事特色工艺晶圆代工，2024 年销售额居中国大陆纯晶圆代工企业第二，由华虹集团间接控股；华力微建有中国大陆首条 12 英寸全自动集成电路芯片制造生产线，工艺覆盖 65/55-40nm，设计月产能 3.8 万片。

华力微 2010 年成立后逐步完成技术与管理体系搭建（2011 年 55nm 试流片、通过 ISO9001 认证）、工艺迭代与业务拓展（2013-2015 年 CIS 产品风险量产、40nm 量产及 28nm 芯片流片成功），并通过华虹六厂建设与汽车电子相关体系认证强化竞争力；2025 年 8 月华虹半导体拟收购其控股权，有望通过资源协同加速发展。华虹集团旗下二者分工明确：华虹半导体以成熟工艺为核心，运营上海、无锡 5 座产线（3 座 8 英寸、2 座 12 英寸），工艺覆盖 180nm-40nm，聚焦功率器件、传感器等特色代工领域；华力微则聚焦 12 英寸，运营华虹五厂（65/55nm-40nm）并控股华虹六厂（28/22nm），集中布局上海产线，聚焦高端逻辑领域。

晶圆代工是集成电路产业链的核心枢纽，上游依赖 EDA 工具、IP 授权、光刻设备及硅片提供技术与原料支撑，中游承接芯片设计方案，通过光刻、蚀刻等工艺将设计图案转移至硅片形成晶圆（工艺直接决定芯片性能与良品率），并对接下游终端应用实现价值落地，对产业链高效运转意义重大。从行业规模看，全球晶圆代工市场 2020-2024 年复合增速 15.4%，2023-2024 年市场规模分别为 1152.0 亿美元、1375.5 亿美元；中国大陆市场表现更优，2024 年规模 130.0 亿美元（占全球 9.4%），同期复合增速 18.8%，显著高于全球水平。从竞争格局看，2025Q1 全球市场高度集中，TrendForce 数据显示，TSMC 以 67.6% 份额居首（凭借 3nm/2nm 先进制程、头部客户绑定及大产能优势），Samsung (8.1%) 受良率、产能分配问题制约份额有限，SMIC (5.5%) 依托政策、28nm 成本及本土需求立足；国产企业华虹集团亦占 2.7% 全球份额，是国产晶圆代工的重要力量。

华虹半导体成立于 2005 年，主营业务聚焦“8 英寸+12 英寸”差异化特色工艺开发与应用，覆盖嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件等领域，核心提供晶圆制造服务，同时形成多元化产品与服务矩阵——除对应工艺的功率器件、模拟与电源管理芯片等外，还配套 IP 设计、测试及晶圆后道加工服务，全方位满足客户半导体制造需求。2024 年公司营业收入 20.04 亿美元，2019-2024 年复合增速约 16.5%，营收

增长稳健；地域结构上，中国内地与中国香港合计占比 81.6%（核心市场），美国、亚洲（不含中国及日本）、欧洲、日本占比分别为 9.4%、5.1%、3.5%、0.3%，市场侧重明确。产销端，2020-2024 年晶圆产量、销量复合增速分别达 20.01%、18.32%，2023-2024 年产销率均超 100%（103.8%、100.7%）。

1.1 华力微简介

上海华力微电子（对应华虹五厂）于 2010 年成立，同年启动建设并完成首台工艺设备搬入，完成初期筹备工作。2011 年 4 月，华力微 55nm 工艺产品试流片，正式开启技术研发；同年 12 月，公司通过 ISO 9001 质量管理体系认证，搭建起质量管控基础，至此完成从设立到技术、管理体系的初步构建。

2013 年 6 月，华力微推进业务拓展，首个 CIS（图像传感器）产品进入风险量产，进一步丰富产品品类；同年 8 月，公司开展技术合作，与赛普拉斯完成 55 纳米嵌入式闪存单元知识产权认证，强化技术合作能力及知识产权储备。2015 年 3 月，华力微实现工艺迭代，40 纳米低功耗工艺开启量产；同年 11 月，公司取得研发突破，与联发科技合作的 28 纳米通信芯片流片成功，显著提升技术竞争力与产品丰富度。

图表 1：华力微发展史梳理



资料来源：华力微官网，爱建证券研究所

注：华力微占上海华力集成电路制造有限公司 54.05%股份

2016 年，上海华力集成电路制造有限公司（对应华虹六厂）登记成立并启动建设项目；同期，华虹五厂通过 QC080000 有害物质过程管理体系认证及 IATF(ISO/TS)16949 汽车产品质量管理体系认证，为拓展汽车电子等产品应用领域奠定基础。2017 年，华虹六厂完成首台工艺设备搬入并正式建成投产；同年 12 月，华虹五厂 28 纳米低功耗工艺进

入量产阶段。

2019 年 5 月，55 纳米 BSI（背照式图像传感器）项目进入量产，进一步丰富产品技术维度；2021 年 8 月，旗下华虹五厂的发明专利“半导体器件的制造方法”荣获第二十二届中国专利优秀奖，技术创新能力获权威认可；2025 年 8 月，华虹半导体公司发布公告，拟收购上海华力微电子有限公司，后续有望通过资源协同，助力华力微在集成电路制造领域迈向更高阶发展。

图表 2：华虹集团晶圆代工产线情况

华虹集团							
	华虹半导体					华力微电子有限公司	华力集成电路制造有限公司
	HH FAB1	HH FAB2	HH FAB3	HHFAB7	HH FAB9	HH FAB5	HH FAB6
启动建设时间	1997	2003	2000	2018	2023	2010	2016
地点	上海	上海	上海	江苏无锡	江苏无锡	上海	上海
晶圆规格(英寸)	8	8	8	12	12	12	12
工艺(nm)	95	180	90	90-65/55	65/55-40	65/55-40	28/22
月产量(万片)	6.50	6.00	5.30	9.50	8.30	3.80	4.00

资料来源：华虹半导体公司公告，华虹集团公司年报，爱建证券研究所

注：华力集成电路制造有限公司（华力微占 54.05%的股份）

华虹半导体与华力微在核心定位、工艺布局及产线规划上存在显著差异。其中，华虹半导体以成熟工艺为根基，旗下运营 Fab 1（8 英寸，月产 6.50 万片）、Fab 2（8 英寸，月产 6.00 万片）、Fab 3（8 英寸，月产 5.30 万片）、Fab 7（12 英寸，月产 9.50 万片）、Fab 9（12 英寸，月产 8.30 万片），以功率器件、传感器等为核心，聚焦特色晶圆代工领域；其客户群体广泛，业务布局兼顾上海与无锡，是集团成熟制程及特色工艺的核心承载主体。

华力微以 12 英寸为核心方向，一方面运营华虹五厂（12 英寸，月产 3.80 万片，工艺覆盖 65/55nm-40nm），另一方面通过持股 54.05% 的华力集成电路制造有限公司掌控华虹六厂（12 英寸，月产 4.00 万片，工艺为 28/22nm）；整体工艺节点更偏向先进水平，聚焦高端逻辑、射频等领域，且产线集中于上海，是华虹集团突破中工艺制程的关键力量。

1.2 全球晶圆代工市场格局

晶圆代工是集成电路产业的重要环节。上游环节中，EDA 工具与 IP 授权为芯片设计搭框架，光刻、蚀刻机等设备及硅片、光刻胶等材料，为制造提供“原料”支撑；中游涵盖 IDM、Fabless、Foundry 等模式，

设计出方案后，晶圆制造通过光刻、蚀刻等工艺将设计图案转移到硅片上成晶圆，其工艺直接决定芯片性能与良品率；下游聚焦终端应用，让芯片在手机、汽车等产品中发挥价值。晶圆制造作为中游“关键枢纽”，承接设计创新、对接下游需求，对产业链高效运转与半导体产业发展至关重要。

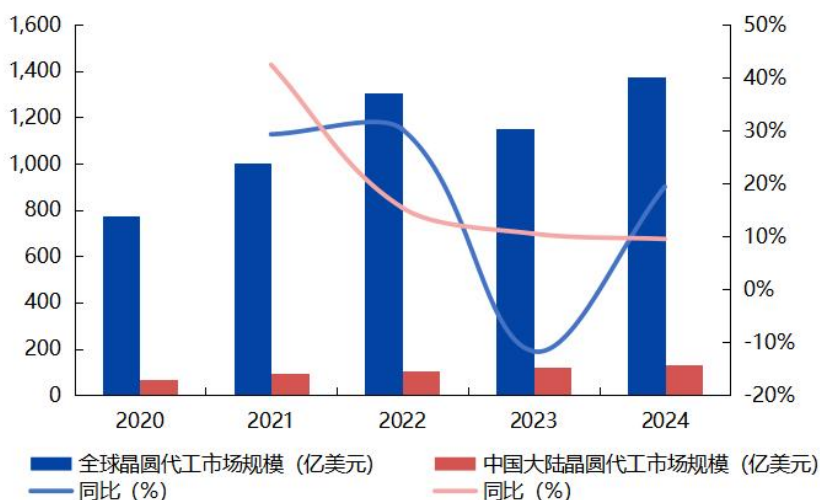
图表 3：晶圆代工是集成电路产业链中重要环节



资料来源：iFinD，51CTO，爱建证券研究所

全球晶圆代工行业规模总体呈上升趋势，2020-2024 年复合增长率达到 15.4%。据 Gartner 和 ICInsight 数据显示，2023 年、2024 年全球晶圆代工市场规模分别为 1152.0 亿美元、1375.5 亿美元。中国大陆 2024 年晶圆代工市场规模为 130.0 亿美元，占据全球 9.4% 的份额；2020-2024 年中国大陆晶圆代工市场规模复合增长率达 18.8%，显著高于全球 15.4% 的同期增速。

图表 4：全球和中国大陆晶圆代工市场规模及同比

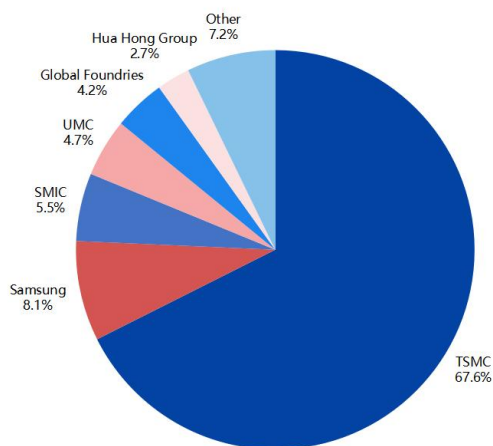


资料来源：Gartner，IC insight，爱建证券研究所

2025Q1 全球晶圆代工市场呈现高度集中化格局。TrendForce 数据显示，2025Q1 全球晶圆代工厂市场份额前五的公司分别是 TSMC（67.6%）、Samsung（8.1%）、SMIC（5.5%）、UMC（4.7%）、Global Foundry（4.2%）。TSMC 凭借 3nm/2nm 先进制程的垄断性技术、与苹果/英伟达等头部客户的深度绑定及全球规模最大的 12 英寸产能，构筑起绝对领先优势；三星虽率先布局 3nm GAA 技术，但受良率瓶颈、IDM 模式下产能分配优先级问题及客户信任危机影响，份额相对有限；SMIC 依托国内政策支持、成熟制程（28nm）的成本优势及本土化客户需求，占据全球一定的晶圆代工市场份额。

值得关注的是，除 SMIC 外，另一家国产企业华虹集团亦在该市场占据重要位置，2025Q1 其全球市场份额达 2.7%。

图表 5：2025Q1 全球晶圆代工厂市场份额



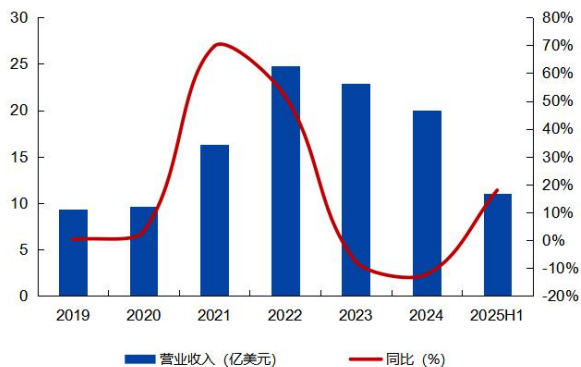
资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

1.3 华虹半导体简介

华虹半导体成立于 2005 年，主营业务聚焦“8 英寸+12 英寸”差异化特色工艺技术的开发与应用，具体涵盖嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理、逻辑及射频等领域，核心为客户提供专业晶圆制造服务。在此基础上，公司形成了多元化产品与服务矩阵，除上述工艺对应的功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理芯片、逻辑与射频芯片外，还配套提供 IP 设计服务、测试服务及晶圆后道加工服务，全方位满足客户在半导体制造环节的需求。

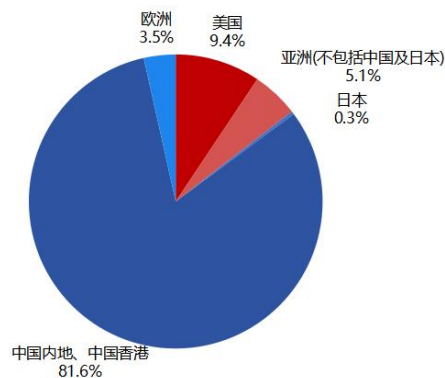
2024 年华虹半导体营业收入达 20.04 亿美元，2019-2024 年复合增速约 16.5%，营收规模与增长势头稳健。从业务结构看，中国内地与中国香港合计占比最高，达 81.6%，是公司最核心的市场；美国市场占比 9.4%，亚洲（不含中国及日本）占比 5.1%，欧洲占比 3.5%，日本占比则仅为 0.3%。

图表 6：华虹半导体营收及同比



资料来源：华虹半导体公司公告，爱建证券研究所

图表 7：2024 年华虹半导体营收（按地区分类）

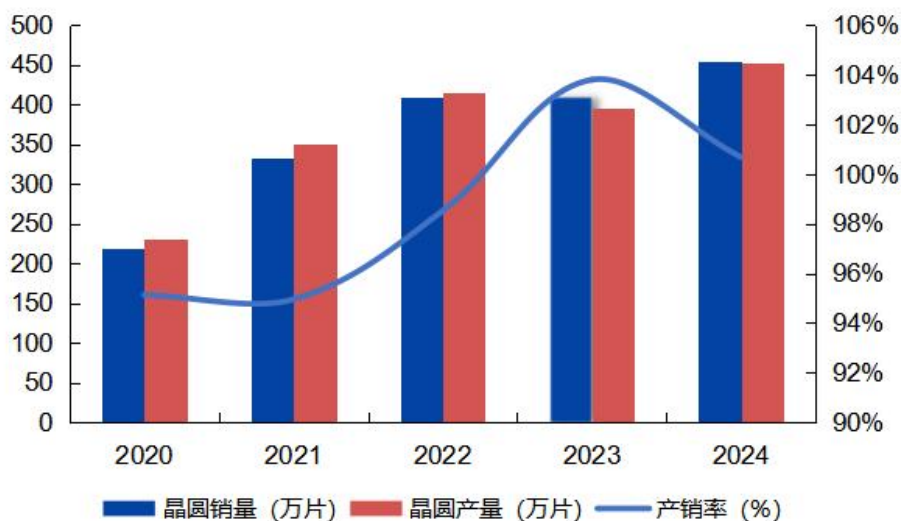


资料来源：华虹半导体公司公告，爱建证券研究所

公司晶圆产量与销量均呈稳步增长趋势。2020-2024 年期间，晶圆产量、销量的复合增长率分别达到 20.01%、18.32%。其中，2023-2024 年公司产销衔接尤为紧密，产销率均超过 100%，分别为 103.8%与 100.7%。

与此同时，华虹半导体持续加大与海外大厂的合作力度。2025 年 5 月 15 日，公司参与意法半导体 2025 年 STM32 峰会线上主题演讲，双方已在华虹无锡基地紧密协作开发 40 纳米 STM32 产品，由华虹半导体代工的 STM32H7 系列产品目前已进入量产筹备阶段。

图表 8：华虹半导体晶圆销量、产量及产销率



资料来源：华虹半导体公司公告，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 小米发布 25Q2 财报

8 月 19 日，小米发布 2025Q2 财报。数据显示，2025Q2 营收达 1160 亿元（同比+30.5%）；经调整净利润 108.3 亿元（同比+75.4%），毛利率达 22.5%。

从细分业务看，智能电动汽车及 AI 等创新业务表现亮眼，收入 213 亿元（同比+233.9%）；手机及 AIoT 分部收入 947 亿元（同比+14.8%）。其中，智能手机收入 455 亿元，出货量连续 8 个季度正增长、连续 20 个季度稳居全球前三；IoT 与生活消费产品收入 387 亿元（同比+44.7%）；智能大家电收入同比增长 66.2%；互联网服务收入 91 亿元（同比+10.1%）。

手机品牌策略上，小米持续推进 Xiaomi 与 REDMI 双品牌协同。2025Q2 智能手机出货量从 2024Q2 的 4220 万部增至 4240 万部，主要源于中国大陆市场出货量 3.6% 的增长。同期，小米以 1150 万台新机激活量登顶国内第一，市场份额达 16.8%。

新零售战略推进方面，2025Q2 中国大陆地区小米之家环比净增超 1700 家，总店数突破 17000 家；境外新零售门店数约 200 家，全球化布局持续深化。

2.2 Deepseek 发布并开源 V3.1 模型

8 月 21 日，DeepSeek 正式发布并开源 DeepSeek-V3.1。该模型采用混合推理架构，支持思考/非思考模式切换，同时将上下文长度拓展至 128k，可处理更长文本生成与处理任务。其思考效率较 DeepSeek-R1-0528 显著提升，能在更短时间内输出答案；经后训练（Post-Training）优化，agent 能力大幅增强，工具使用与智能体任务表现更优。

官方网页、APP、小程序及 API 开放平台调用的模型已同步更新。用户可通过对话框“深度思考”按钮，自由切换推理模式；API 接口调用方式不变，新增 AnthropicAPI 格式支持，便于开发者接入 ClaudeCode 框架。

测试数据显示，V3.1 在多场景表现突出：代码修复测评 SWE、命令行终端复杂任务（Terminal-Bench）中，性能较前代 DeepSeek 系列明显提升；搜索评测中，多步推理复杂搜索（browsecomp）与多学科专家级难题（HLE）测试性能大幅领先 R1-0528。

输出控制方面，V3.1 经思维链压缩训练后，Think 模式输出 token

数减少 20%-50%，仍保持与 R1-0528 持平的平均表现；非思考模式下，输出长度较 DeepSeek-V3-0324 明显缩短，且不影响模型性能。

此外，V3.1 的 Base 模型在 V3 基础上新增 840Btokens 外扩训练，目前 Base 模型与后训练模型已同步在 Huggingface 及魔搭平台开源。

2.3 软银集团宣布 20 亿美元投资英特尔

2025 年 8 月 19 日，英特尔与软银集团联合宣布，双方已正式签署最终股份购买协议。根据该协议，软银将以每股 23 美元的价格认购英特尔普通股，总投资金额共计 20 亿美元。

此次交易完成后，软银将成为英特尔的第五大股东。双方在联合声明中强调，此次投资充分体现了双方携手推动美国先进技术与半导体产业创新的坚定决心。

对于此次投资，软银集团管理层表示，半导体是所有产业的核心基石，软银做出这一战略投资，核心原因是对美国先进半导体制造及供应链未来发展潜力的坚定信心，而英特尔在这一进程中必将发挥关键作用。英特尔管理层则回应称，非常荣幸能与软银深化合作，未来双方将共同发力，巩固并提升美国在全球技术与制造业领域的领先地位。

2.4 高通发布新骁龙 W5

8 月 21 日，高通正式推出第二代骁龙 W5+ 和第二代骁龙 W5 可穿戴平台，二者为全球首批支持 NB-NTN 卫星通信的可穿戴平台。

两款平台均基于 4nm 工艺，提供双版本选择：搭载低功耗协处理器的第二代骁龙 W5+，及无协处理器的第二代骁龙 W5，其 GPS 定位精度较前代提升达 50%。其中，第二代骁龙 W5 的射频前端（RFFE）经优化，尺寸较前代缩小约 20%且功耗降低，可助力厂商打造更轻薄设备并延长电池续航。

系统与应用层面，该平台兼容最新 Wear OS，已率先应用于 Pixel Watch4，且针对多设备协同、无缝集成等特性深度优化。本次升级的核心亮点是首次将卫星通信能力引入可穿戴领域——依托 Skylo 的 NB-NTN 技术，支持设备直接双向应急消息通信，能为偏远无蜂窝网络地区用户提供保障，例如探险者紧急时可通过设备发送 SOS 信息，无需依赖地面移动网络。

高通管理层表示，第二代骁龙 W5+ 与 W5 平台将持续引领可穿戴技术创新，推动 WearOS 成为首个集成 NB-NTN 的操作系统，进一步拓展可穿戴设备应用边界。

2.5 谷歌发布 Pixel 10 系列

8 月 21 日，谷歌正式发布 Pixel 10 系列，包含 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 三款直板旗舰，另有折叠屏旗舰 Pixel 10 Pro Fold 同步推出。

工业设计方面，Pixel 10 系列直板机型延续上代设计语言，采用横置相机模组，三款机型的核心差异在于配置与尺寸：Pixel 10、Pixel 10 Pro 均为 6.3 英寸，Pixel 10 Pro XL 则为 6.8 英寸；折叠屏 Pixel 10 Pro Fold 后置镜头 DECO 采用矩阵式设计，配备 6.4 英寸外屏与 8 英寸内屏，支持 120Hz 高刷新率。

系统层面，全系列机型均搭载全新安卓 16 操作系统，谷歌官方承诺提供 7 年系统更新支持，为用户带来长期使用保障；需要注意的是，三款直板机型出厂标配数据线，但未附带充电器。

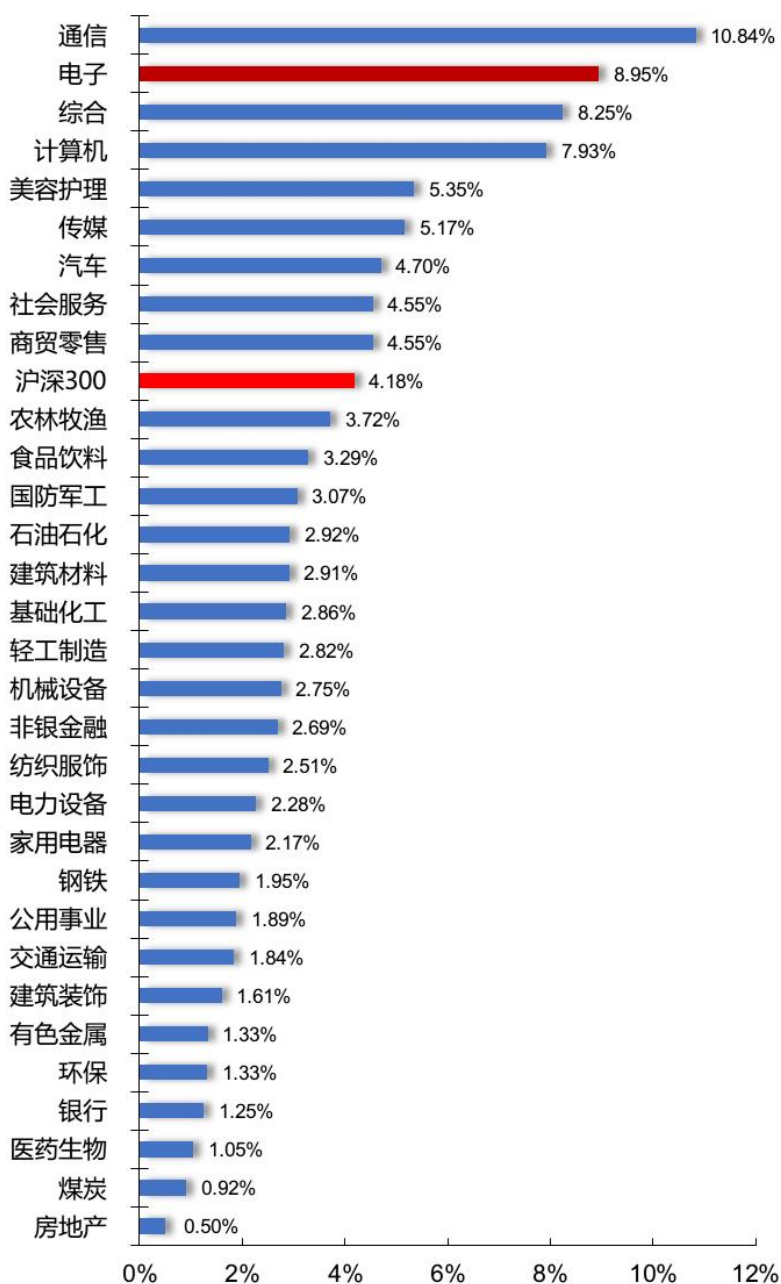
核心配置上，Pixel 10 系列直板机型全系首发谷歌 Tensor G5 处理器，性能表现一致。

3. 本周市场回顾

3.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数(+8.95%), 涨跌幅排名 2/31 位, 沪深 300 指数(+4.18%)。
SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为: 通信(+10.84%), 电子(+8.95%), 综合(+8.25%), 计算机(+7.93%), 美容护理(+5.35%), 涨跌幅后五分别为: 房地产(+0.50%), 煤炭(+0.92%), 医药生物(+1.05%), 银行(+1.25%), 环保(+1.33%)。

图表 9: 本周 SW 一级行业涨跌幅一览

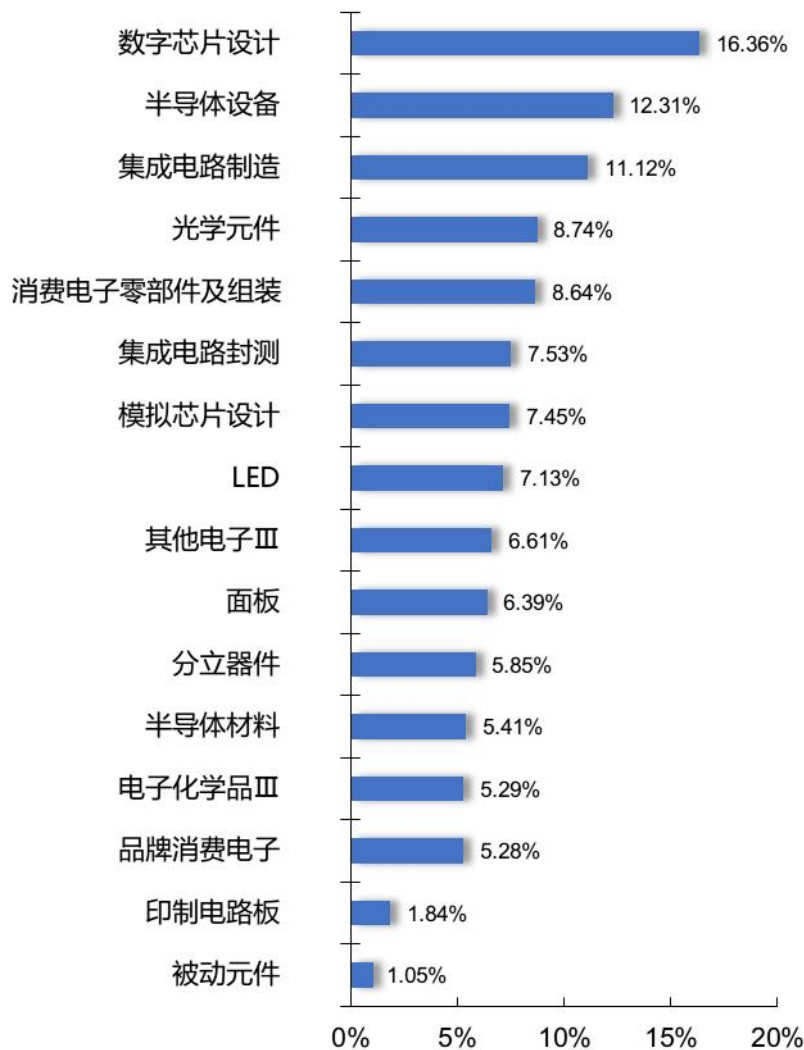


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：数字芯片设计 (+16.36%)，半导体设备 (+12.31%)，集成电路制造 (+11.12%)；涨跌幅后三分别是：被动元件 (+1.05%)，印制电路板 (+1.84%)，品牌消费电子 (+5.28%)。

图表 10：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



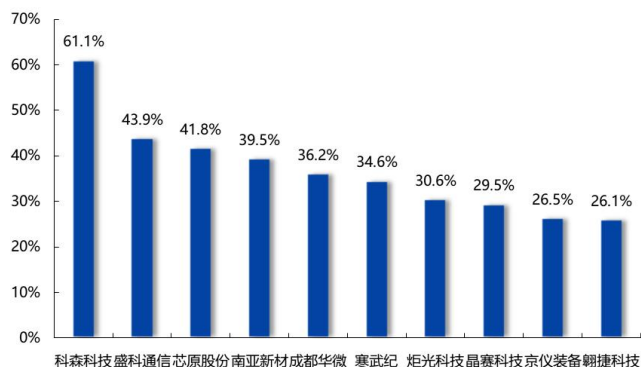
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前十的股票分别是：科森科技 (+61.1%)，盛科通信 (+43.9%)，芯原股份 (+41.8%)，南亚新材 (+39.5%)，成都华微 (+36.2%)，寒武纪 (+34.6%)，炬光科技 (+30.6%)，晶赛科技 (+29.5%)，京仪装备 (+26.5%)，翱捷科技 (+26.1%)。

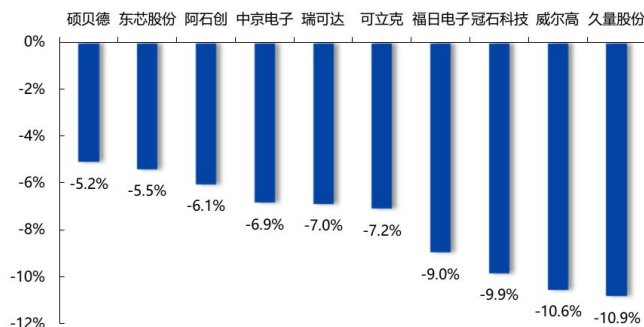
涨跌幅排名后十的股票分别是：久量股份 (-10.9%)，威尔高 (-10.6%)，冠石科技 (-9.9%)，福日电子 (-9.0%)，可立克 (-7.2%)，瑞可达 (-7.0%)，中京电子 (-6.9%)，阿石创 (-6.1%)，东芯股份 (-5.5%)，硕贝德 (-5.2%)。

图表 11: SW 电子个股本周涨跌幅前十



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 12: SW 电子个股本周涨跌幅后十

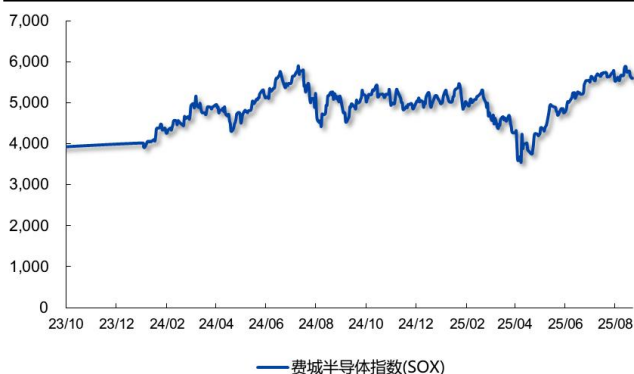


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.4 SW 科技行业其他市场表现

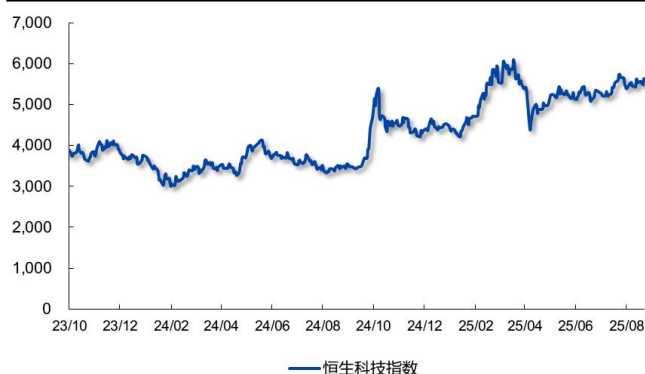
费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+0.03%; 恒生科技指数本周涨跌幅为+1.89%。

图表 13: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

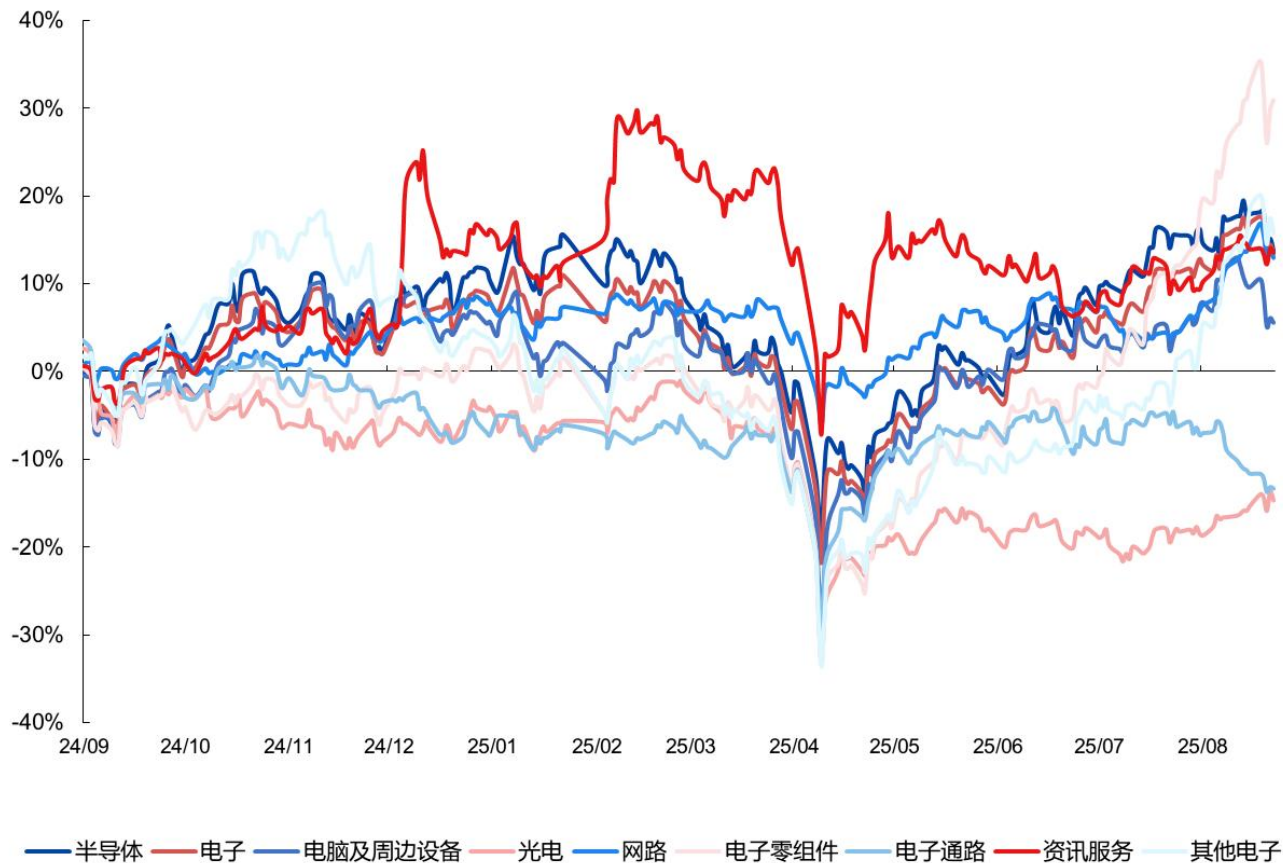
图表 14: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是: 半导体 (-3.55%), 电子 (-3.05%), 电脑及周边设备 (-3.71%), 光电 (+0.72%), 网路 (-1.39%), 电子零组件 (-1.31%), 电子通路 (-1.93%), 资讯服务 (-0.30%), 其他电子 (-2.41%)。

图表 15：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

4. 风险提示

- 1) 国际贸易摩擦加剧
- 2) 下游需求不及预期
- 3) 技术升级进度滞后

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。